

导热硅胶薄材 XK-R30

简介:

XK-R 系列为无基材硅胶导热薄材, 比传统玻纤布更好的导热与填缝能力, 导热系数 1~4.8W/mk , 比传统硅胶片更薄的界面厚度(BLT), 适合 0.2~0.5mm 范围的价格竞争的应用

特性:

超薄厚度(0.2~0.5mm)

无基材设计

适当的压缩性

高性价比

应用:

消费性电子产品

自动化设备、军规设备、医疗设备



	unit	XK-R30	Method
Thickness	mm	0.2~10	ASTM D374
Specific Gravity	g/cm ³	3	ASTM D792
Hardness	Shore A	50	ASTM D2240
Thermal Conductivity	W/mK	3	HOT DISK
Volume Resistivity	Ωcm	>10 ¹³	ASTM D257
Breakdown Voltage	KV/mm	15	ASTM D149
Dielectric Constant	1	7	ASTM D150
Application temperature	°C	-50~200	
Tensile strength	psi	80	ASTM D149
Elongation	%	80	ASTM D149
Siloxane Volatiles D4~D20	%	<0.01	GC-FID
Flammability	UL94	V-0	UL94